



3D・チップレット研究会第4回公開研究会

主催: システムインテグレーション(SI)実装技術委員会
協賛: 日本半導体製造装置協会(SEAJ)、日本電子回路工業会(JPCA)、
システムデバイスロードマップ産学連携委員会(SDRJ)、SEMIジャパン

◆公開研究会のご案内

1つのチップにすべての機能を収納するSoCの時代から、機能ごとにチップを製造し、これらをインテグレーションするチップレット集積の時代への移行が始まっています。チップレット集積には様々な実装構造が議論されており、さらには3DIC(3次元集積化デバイス)も合わせて議論されています。

今回は、3D・チップレット実装に関わる実際の先端技術開発とその動向の4回目となり、各専門家の方々にご紹介頂き、皆様と一緒に技術課題や方向性を考えてみたいと思います。皆様方の積極的なご参加をお待ちしています。

テーマ: 『2.xDおよび3D実装技術の最新開発動向(その4)』

開催日時 2023年12月8日(金) 13:00~17:15(予定)
開催方式 会場現地とオンラインのハイブリッド
開催場所 ①オムロン京都センタービル・みやこホール(先着80名様まで:12/5ㄨ切)
京都市下京区塩小路通堀川東入(JR/地下鉄/近鉄・京都駅徒歩約5~10分)
②Zoom Webinar(先着300名様まで:12/7ㄨ切)
※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します

◆プログラム ※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

13:00~13:05

開催にあたって

Rapidus株式会社 専務執行役員 折井 靖光 氏 (3D・チップレット研究会主査)

13:05~13:50

「進化する半導体技術: 集積回路から集積チップレットへ」

東北大学 未来科学技術共同研究センター シニアリサーチフェロー 小柳 光正 先生

13:50~14:35

「System-Level Integration with 2D and 3D Heterogeneous Integration」

アプライマテリアルズジャパン株式会社 グローバルアカウント事業部 技術本部長 松永 範昭 氏

14:35~15:20

「ヘテロロジーニアスインテグレーション対応した先端パッケージ基板の開発動向」

新光電気工業株式会社 開発統括部 主任研究員 三木 翔太 氏

(休憩10分)

15:30~16:15

「プロセッサ市場の動向とPKG(仮)」

みずほ証券株式会社 エクイティ調査部 シニアアナリスト 山本 義継 氏

16:15~17:00

「パッケージ基板の市場動向と今後の技術トレンド」

AZ Supply Chain Solutions オーナー 亀和田 忠司 氏

<次頁につづく>

(つづき)

17:00~17:15

オムロン株式会社様から3Dチップレット関連の検査装置等のご紹介
SEMICON Japan 2023 APCS【12/13(水)~15(金)】紹介: SEMIジャパン様より
終わりに: 日本IBM株式会社 東京基礎研究所 部長 堀部 晃啓 氏 (SI実装技術委員会委員長)

参加要項

定員 会場① 80名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)
会場② 300名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員:3,000円、学生会員:1,000円、研究会会員:別払い、シニア会員:2,000円
名誉会員:無料、賛助会員の社員:3,000円、賛助会員(クーポン利用):無料
非会員一般:10,000円 非会員学生:2,000円 協賛団体会員:3,000円

[JIEP会員登録](下記URLから会員登録が可能です。)

<https://jiep.or.jp/admission/adm-guide.html>

会員特典

- 参加費割引(今回公開研究会から会員価格が適用されます。)
- 学会誌配布(年7回。ただし入会月からの配布)
- 10月からは、本年度の年会費が半額の5000円で入会できます。

注意事項(参加方法を含む)

- ①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
- ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。
(お支払い方法:銀行振込・クレジットカード決済)
- ③請求書や振込確認後の領収書のご発行は、返信メールのマイページから出力が可能です。
- ④WEBの請求書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
- ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで(複数口の場合は口数分)利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。

* キャンセルポリシー:お申込み後のキャンセルはできません。

* 以下についてご注意ください。

- ・講演やセミナー、スピーチなども著作物となります。録画、録音、撮影は著作権侵害に当たります。
- ・登壇者(話者)に無断で、内容を配信することは公衆送信権の侵害となります。
- ・非営利目的の配信でも損害賠償責任を負うことがあります。

* メールアドレス入力ミスで、返信(受付完了)メールが不達になることが頻発しています。

もう一度、メールアドレスを入力後に再確認をお願いいたします。

下記から参加申し込みをお願いします。

会員/賛助/非会員の方

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会
E-mail: info@jiep.or.jp (メールアドレスは¥を@に置き換えてください)